

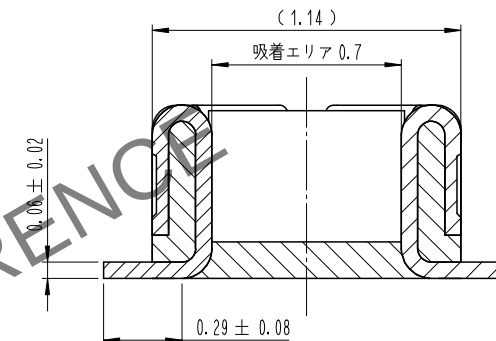
PART No.	CODE No.	POS.	B	C	D
BM23PF0.8-10DP-0.35V(51)	-	10	3.49	1.40	2.70
BM23PF0.8-14DP-0.35V(51)	-	14	4.19	2.10	3.40
BM23PF0.8-20DP-0.35V(51)	-	20	5.24	3.15	4.45
BM23PF0.8-24DP-0.35V(51)	-	24	5.94	3.85	5.15
BM23PF0.8-30DP-0.35V(51)	-	30	6.99	4.90	6.20
BM23PF0.8-40DP-0.35V(51)	-	40	8.74	6.65	7.95
BM23PF0.8-42DP-0.35V(51)	-	42	9.09	7.00	8.30
BM23PF0.8-44DP-0.35V(51)	-	44	9.44	7.35	8.65
BM23PF0.8-46DP-0.35V(51)	-	46	9.79	7.70	9.00
BM23PF0.8-50DP-0.35V(51)	-	50	10.49	8.40	9.70
BM23PF0.8-54DP-0.35V(51)	-	54	11.19	9.10	10.40
BM23PF0.8-64DP-0.35V(51)	-	64	12.94	10.85	12.15

注 1. 平坦度は0.08mm以下となります。

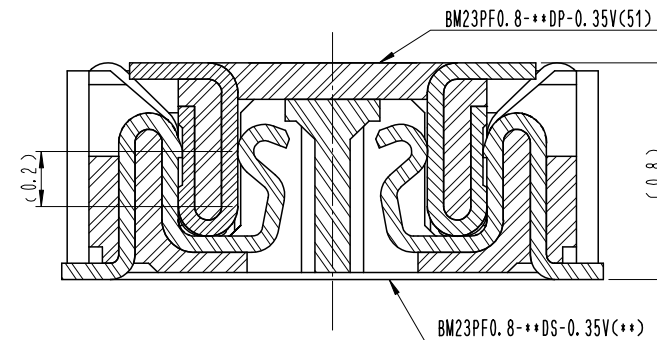
- ② 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
- ③ 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
- ④ 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。
- ⑤ 製品側面に凹みを設ける場合があります。

COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
3	RE-6-1784	PSH	JHW	20.04.09							
2	RE-6-1994	PSH	JHW	20.09.07							

A:A(50:1)

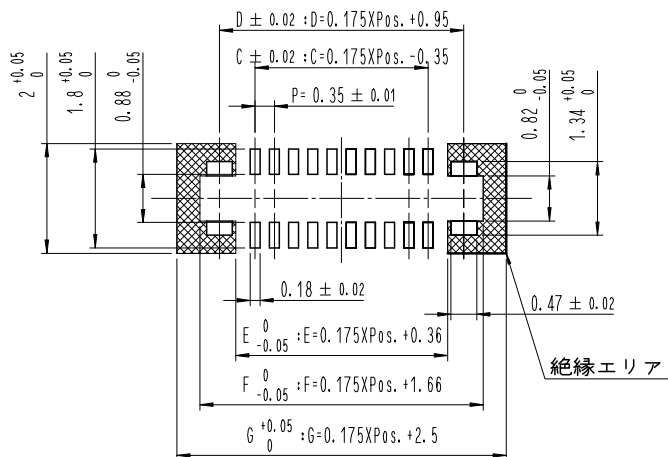


嵌合断面図 (50:1)



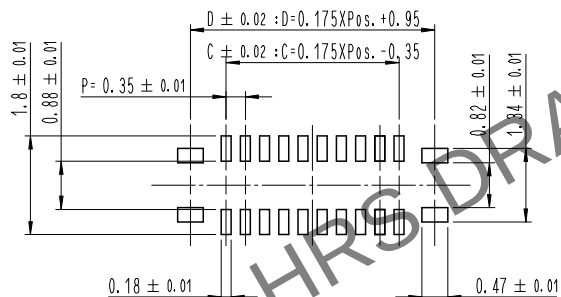
4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ 		7	PS	CLEAR, 補強用カラー		
3	りん青銅			6	PS	BLACK, プラスチックリール		
2	りん青銅			5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ		
1	LCP	UL94 V-0, BLACK						
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
REMARKS				DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
				S. H. MOON	S. H. MOON	H. W. JO	T. S. KANG	17.01.26
				17.01.26	17.01.26	17.01.26	17.01.26	
CODE NO. (OLD)		DRAWING NO. JDC3-*****		PART NO. BM23PF0.8-**DP-0.35V(51)				
	SCALE 10:1							
	UNITS	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO CL 66*-**--*-51				
								
								

7>◆推奨基板パターン図



◆推奨メタルマスク開口部図

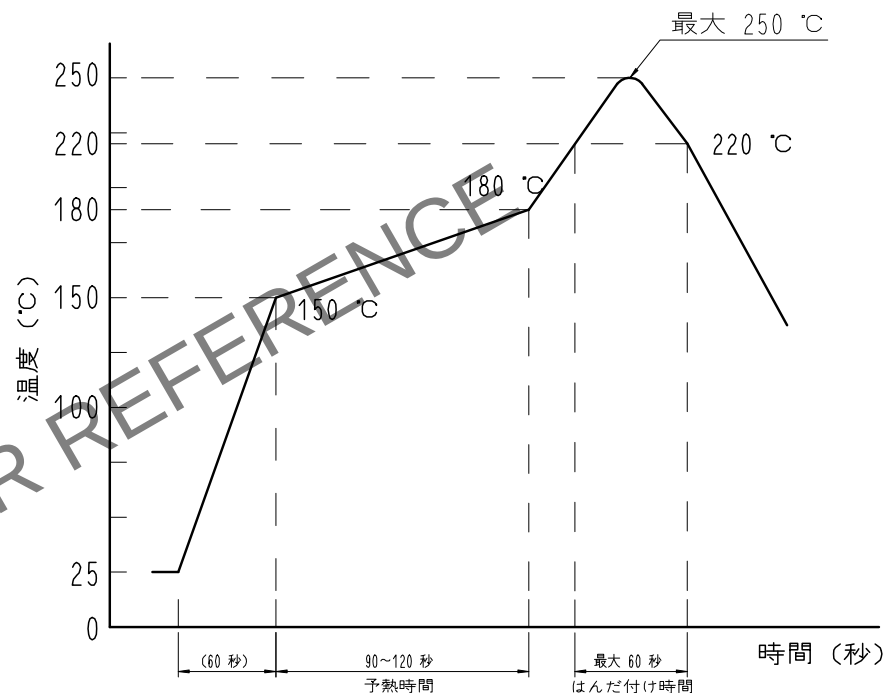
メタルマスク厚 : 100 μm



△

POS.	C	D	E	F	G
10	1.40	2.70	2.11	3.41	4.25
14	2.10	3.40	2.81	4.11	4.95
20	3.15	4.45	3.86	5.16	6.00
24	3.85	5.15	4.56	5.86	6.70
30	4.90	6.20	5.61	6.91	7.75
40	6.65	7.95	7.36	8.66	9.50
42	7.00	8.30	7.71	9.01	9.85
44	7.35	8.65	8.06	9.36	10.20
46	7.70	9.00	8.41	9.71	10.55
50	8.40	9.70	9.11	10.41	11.25
54	9.10	10.40	9.81	11.11	11.95
64	10.85	12.15	11.56	12.86	13.70

△6>鉛フリークリームはんだの温度プロファイル(推奨)



リフロー方式 : N₂ リフロー

リフロー回数 : 2回以下

1)本加熱

220℃以上 60秒以下 (ピーク温度250℃)

2)予備加熱

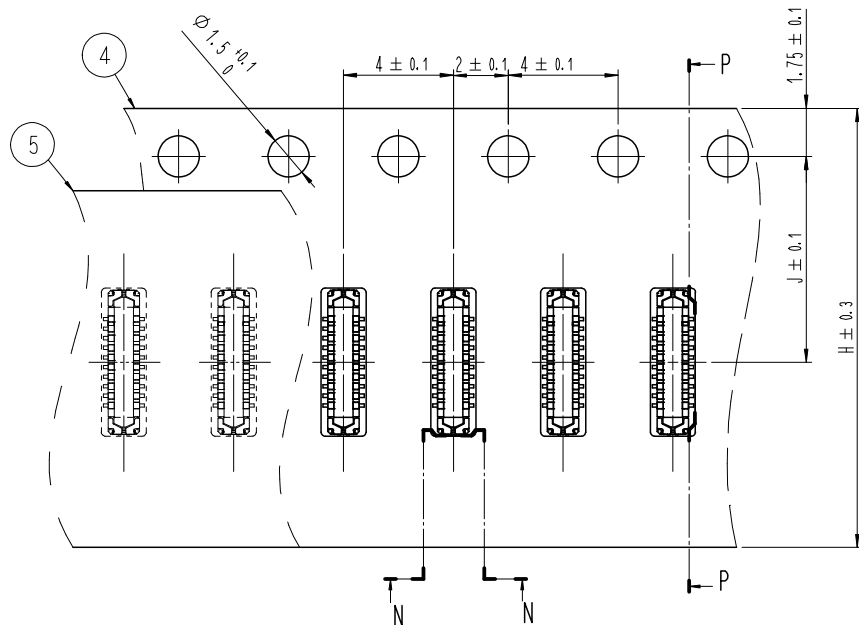
150~180℃ 90~120秒

6> 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。

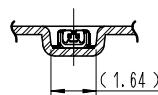
7> 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

DRAWING NO.	JDC3-*****	PART NO.	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 66**-*****-51
UNITS	mm		
	HIROSE KOREA CO.,LTD.		

エンボスキャリアテープ (5:1)

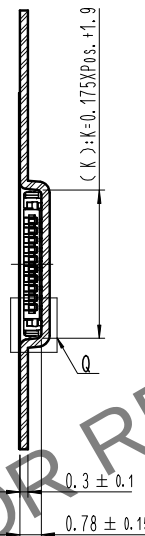


N-N (5:1)

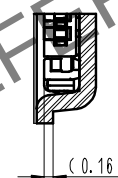


引き出し方向

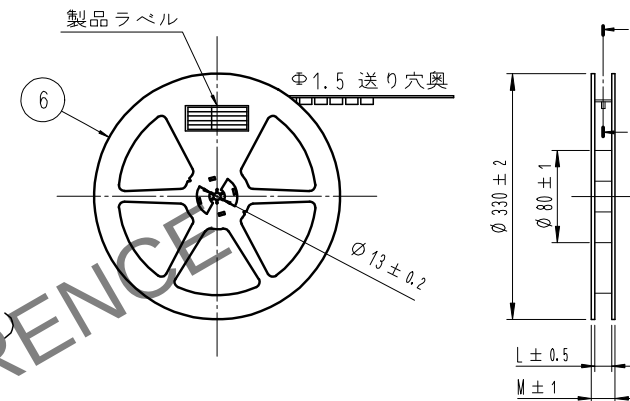
P-P (5:1)



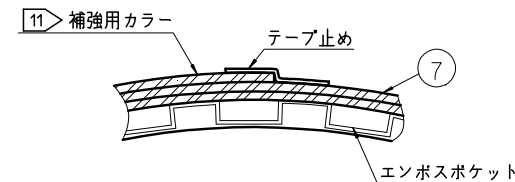
Q (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



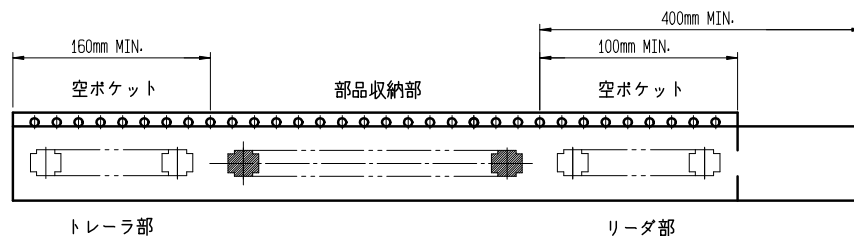
S-S (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	HIROSE
QUANTITY	10,000
PART NO.	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
CODE NO.	CL 66**-*****-51
DATE OF MANUFACTURED	2024.04.01
生産月日	年 月 日
図番	** ** *
品名	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
納入数量	10,000個
納入者	HIROSE KOREA

10 テーピング (Free)



8 . 1リール10,000個巻きです。

9 . () 内寸法は参考寸法です。

10 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

11 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております。

DRAWING NO.	JDC3-*****	PART NO.	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
SCALE	10:1	CODE NO.	CL 66**-*****-51
UNITS	mm		
HIROSE	HIROSE KOREA CO.,LTD.		